

メカトロニクス事業



21/3期 連結売上高概況、重点施策進捗

- 前期比37.3%減
- ■CSW：中国の5G関連需要拡大により売上増
- ■OLB：MDB/DBの貼合技術をウェアラブルへ展開
- コロナ禍の影響を大きく受けるも、中国生産、中国立上体制が生産性の向上に寄与

22/3期 連結売上高計画

45億円

22/3期 重点施策計画

- 売上高底上げ：拡販強化（■OLB, ■DB, ■CSW）
- 競争力強化：高付加価値化・生産性向上
- 新規市場の開拓：123期売上に寄与

※ **CSW**(Cap Seal Welder;光半導体用溶接機), **RMW**(自動車部品用大型溶接機), **MDB**(Mobile Display Bonder),車載・産業用**DB**(Display Bonder), **OLB** (Optical Lens Bonder;光学レンズ貼合せ装置), **VSM**(真空ソルダリングシステム)

メカトロニクス事業 21/3期重点施策進捗詳細



【拡販強化】

➤ ■CSW

中国における5G関連の光通信モジュール需要拡大のもと、海外生産推進によるコスト低減、及び短納期化を実現し、売上増（前期比353%増）



CS3-2.1



PIXTA

【拡販強化】

➤ ■OLB

MDB/DBで培った貼合技術をレンズ貼合に展開、120期よりウェアラブル市場において売上に寄与



【生産性向上】

➤ 海外生産*中国

- ・中国現地生産体制確立
計画的な生産による短納期対応とコスト低減を実現
- ・現地立上/サポート体制構築
コロナ禍においても滞りない現地据付で貢献



PIXTA

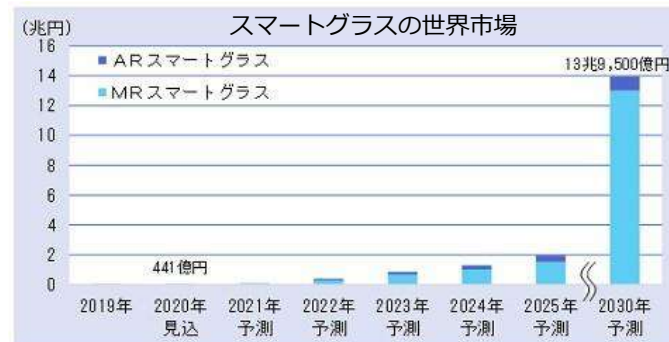
メカトロニクス事業 22/3期重点施策計画詳細



【市場別戦略による販売強化への取組み（注力市場と市場動向）】

➤ ■ OLB

現行のIT機器を代替するモバイル端末として期待され、立ち上がりが見込まれる **ウェアラブル市場**
 ➔メカトロニクス事業部の基幹事業のひとつとして捉え、製品化を進め、本市場での深耕を図り、拡販



出典:「AR/VR関連市場の将来展望2020」(富士キメラ総研)

➤ ■ DB

採用拡大が見込まれる **車載・産業用ディスプレイ市場**
 ➔大型化やマルチディスプレイ等、多様化する市場要求に応え、日本・中国・アジア・欧州で実績拡大
 ➔欧州拠点整備への取組み



注1. オートカー仕向数値ベース
 注2. 2020年以降は予測値
 注3. 自動運転に使用されるSCID (Center Information Display)・Cluster (Instrument Cluster)・Digital Cockpit (統合Cockpit)・ROE (Rear Seat Entertainment)・HUD (Head-up Display)・Mirror (Rearview Mirror / Side Mirror) 向けSCID・TFT・AM-OLED・Micro LEDを対象とした。純正品および市販品を含む。
 出典:2020-2021年版 車載用ディスプレイ市場の現状と将来展望(矢野経済研究所)

➤ ■ CSW

中国における急速な展開見せる **5G関連市場**
 ➔高精度化とコスト低減の取組みを継続し、拡販推進
 ➔光通信用途以外にも期待



出典:2020年版 5G関連デバイスの現状と展望(矢野経済研究所)